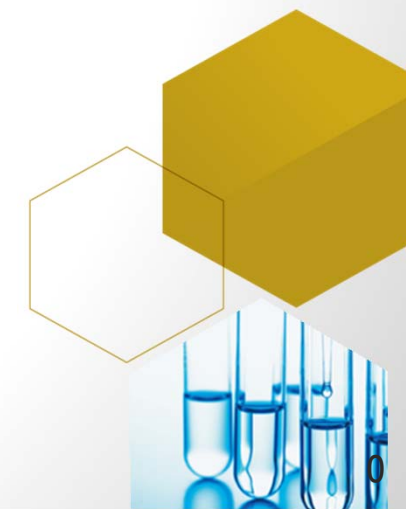
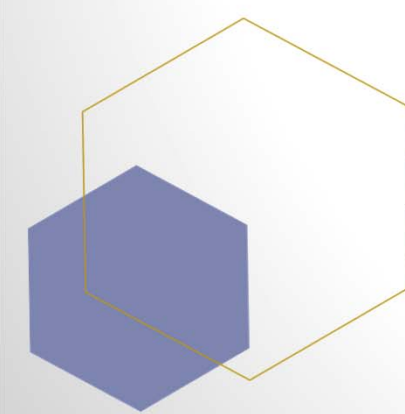



2019年3月期 決算説明資料



 日本高純度化学株式会社

証券コード:4973

2019年4月23日



2019年3月期の概況

電子部品業界の状況

- スマートフォン市場の飽和に伴い、鈍化傾向が見受けられた。
- 特に中国市場でのハイエンドスマートフォン需要の鈍化が電子部品の生産調整を招き消費が落ち込んだ。

当社決算の概況

- 技術的な優位性から中華系高機能スマートフォンの需要に支えられて堅調に推移した。
- リードフレーム用パラジウムめっき薬品の販売については、半導体需要の低迷から減収となった。

2019年3月期 決算概況

(単位:百万円、%)

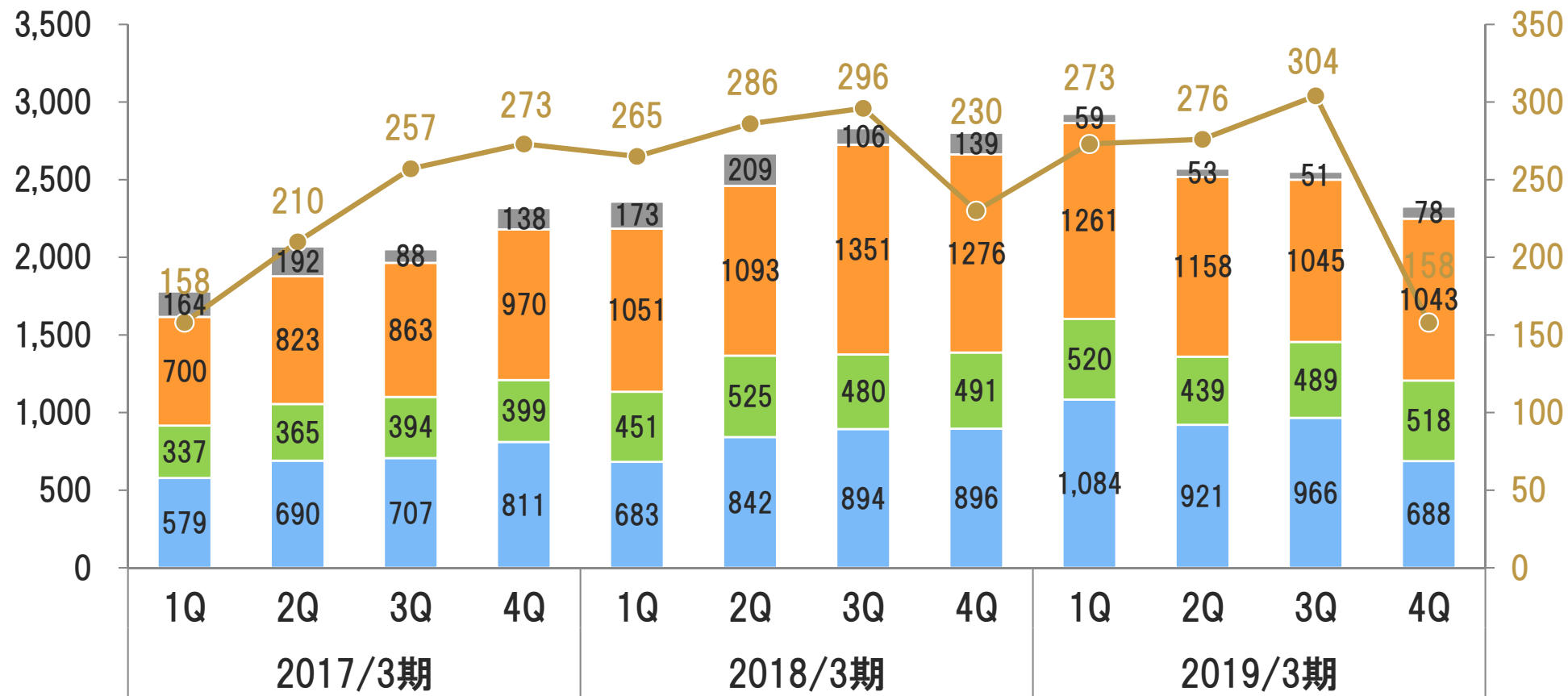
	2018/ 3期	2019/3期						2019/3期予想	
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計	増減率		達成率
売上高	10,668	2,925	2,573	2,553	2,329	10,380	△2.7	10,200	101.8
営業利益	1,078	273	276	304	158	1,013	△6.1	1,130	89.7
経常利益	1,179	343	282	359	169	1,155	△2.1	1,230	93.9
純利益	829	251	203	262	125	844	1.8	860	98.1
1株当たり 当期純利益	144.13円	43.71円	35.32円	45.55円	21.80円	146.36円	—	149.36円	—

売上高・営業利益の推移(四半期ベース)

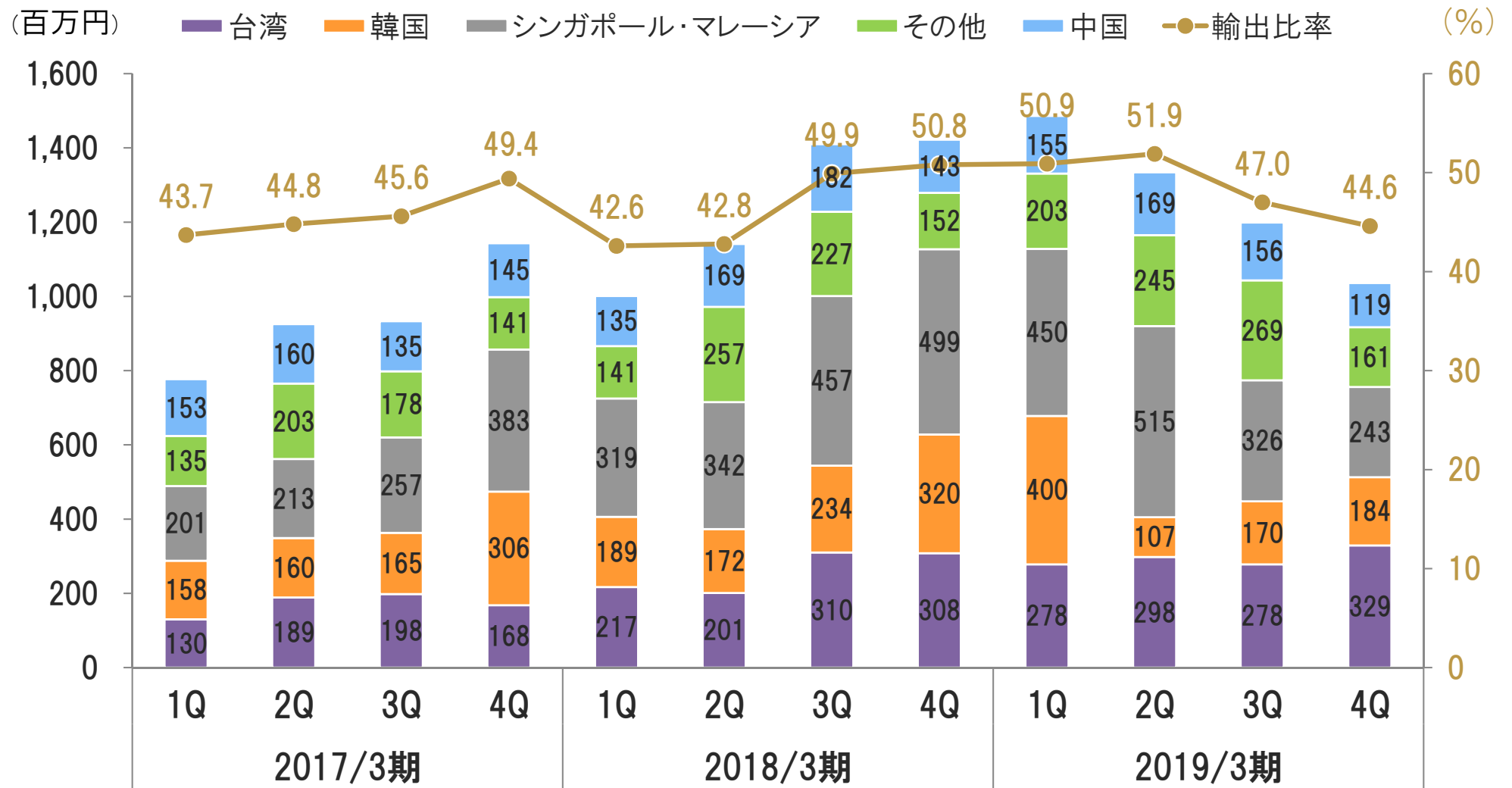
(百万円)

- プリント基板・半導体搭載基板用
- コネクター・マイクロスイッチ用
- リードフレーム用
- その他
- 営業利益

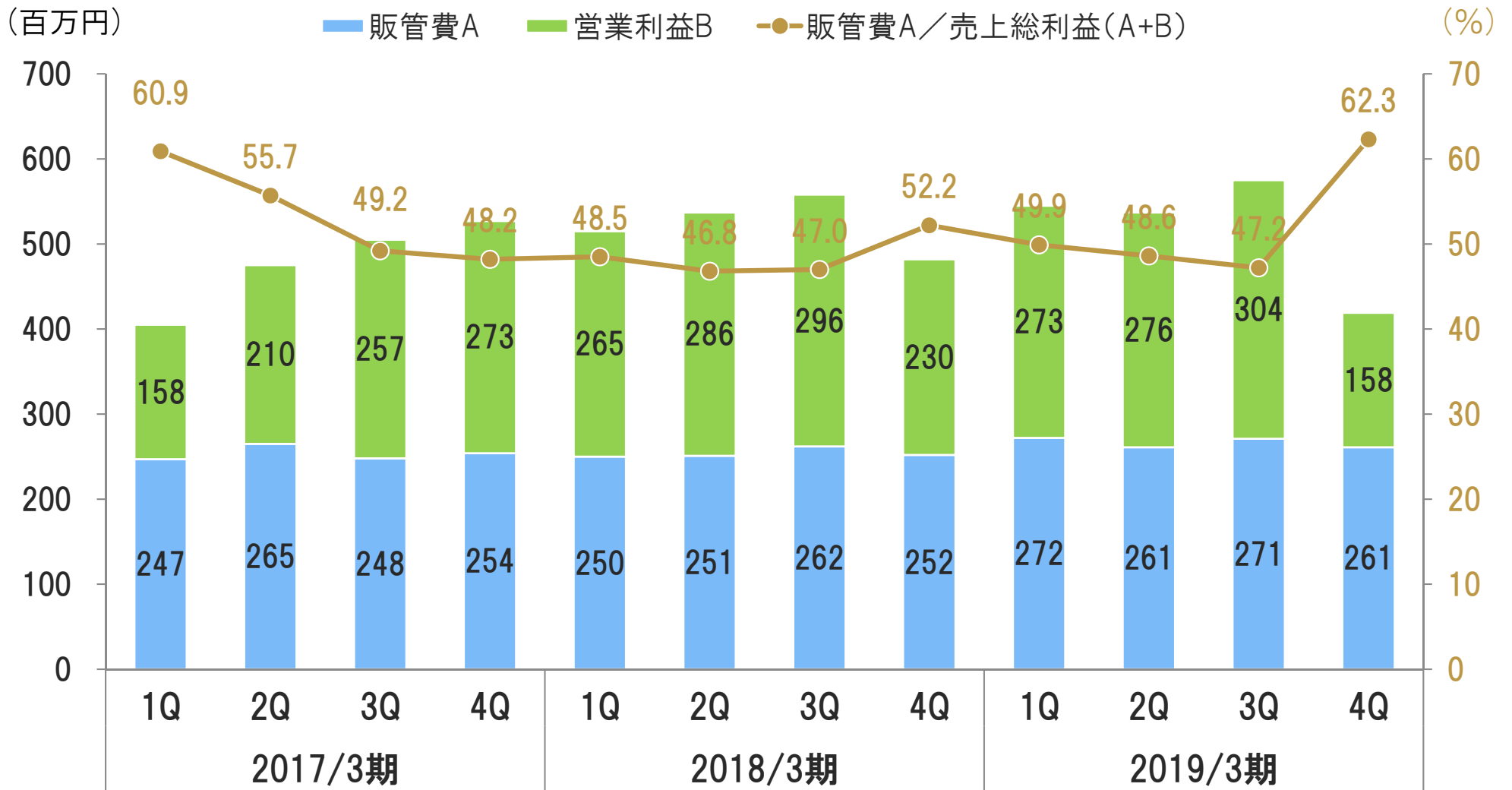
(百万円)



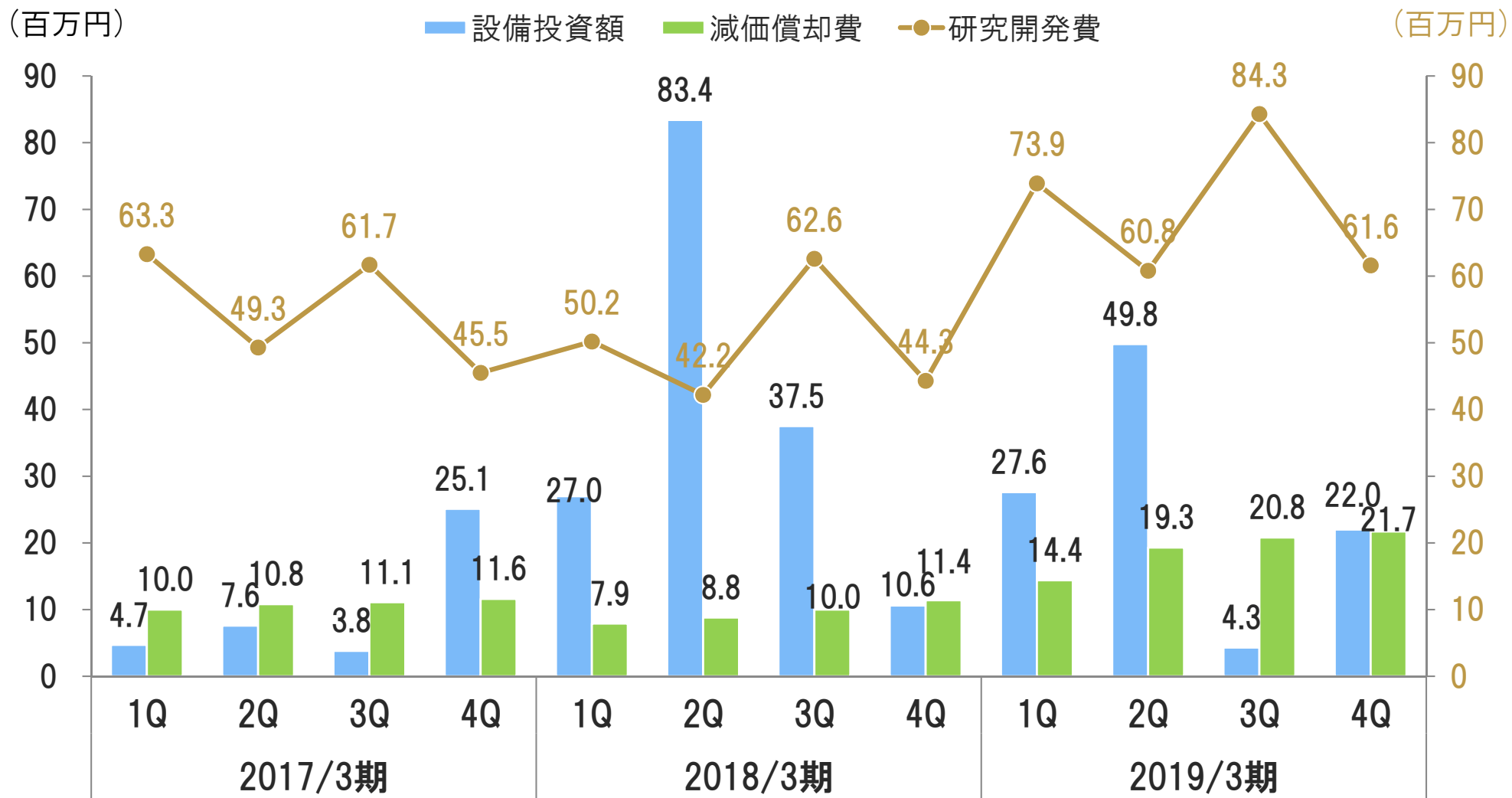
輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)



販売管理費および営業利益の推移



設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



配当政策およびESG情報

1株当たり配当金

(単位:円、%)

	通期	EPS	配当性向
2016/3期	80	121.31	65.9
2017/3期	80	124.44	64.3
2018/3期	80	144.13	55.5
2019/3期	80	146.36	54.7
2020/3期(予想)	80	135.15	59.2

ESGに関する取り組み

- **環境配慮**・・・限られた貴金属資源の有効利用のため、省金製品を顧客に訴求
- **社会貢献**・・・CSRガイドラインを策定し、重点仕入先との共有を図る(2018年12月)
学生の奨学援助を目的にJPC奨学財団を設立(2019年2月)
- **ガバナンス強化**・・・改訂CGコードを踏まえたCGに関する報告書を開示(2018年12月)

通期の見通し

(単位:百万円、%)

	2019/3期			2020/3期		
		構成比	前期比		構成比	前期比
売上高	10,380	100.0	△2.7	10,500	100.0	1.1
営業利益	1,013	9.8	△6.1	1,000	9.5	△1.3
経常利益	1,155	11.1	△2.1	1,120	10.7	△3.1
当期純利益	844	8.1	1.8	780	7.4	△7.6

トピックス

- **硬質金(金合金)**・・・マイクロコネクタ用硬質金めっきの改良製品の投入により、利益向上を見込む
- **ENIG(置換金)**・・・電子部品の世界の工場として伸長する東南アジア市場にて需要拡大
- **DIG(銅上ダイレクト金)**・・・ENIGに代わる高周波特性・高解像度対応プロセスとして拡販中
- **EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)**・・・巨大なIoT市場に展開できるよう、技術・営業両面でフォロー中

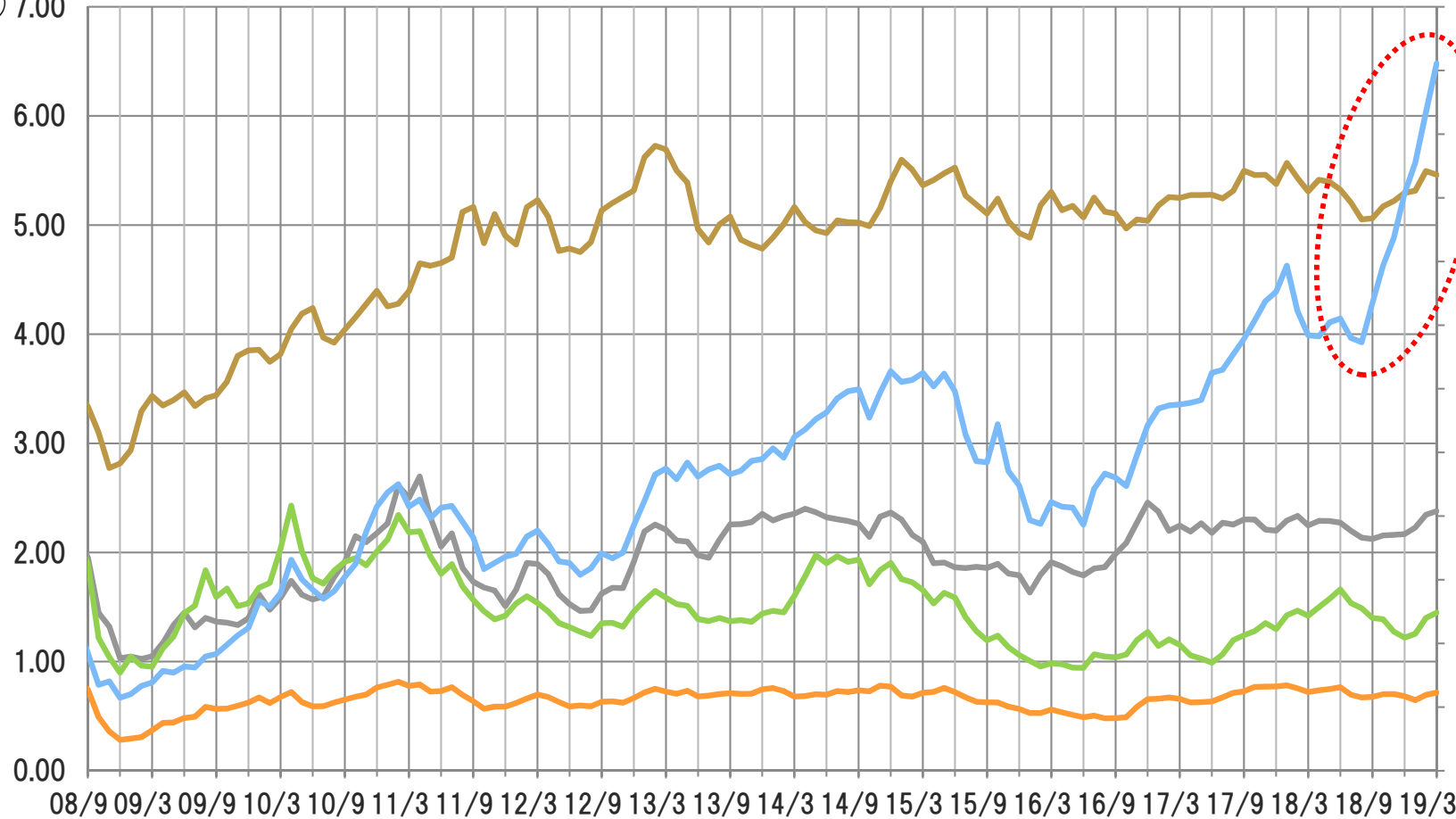
いずれも業界動向や顧客ニーズに迅速に対応できるよう積極的に拡販活動をおこなっております。

メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

Copper 銅
Tin スズ
Nickel ニッケル

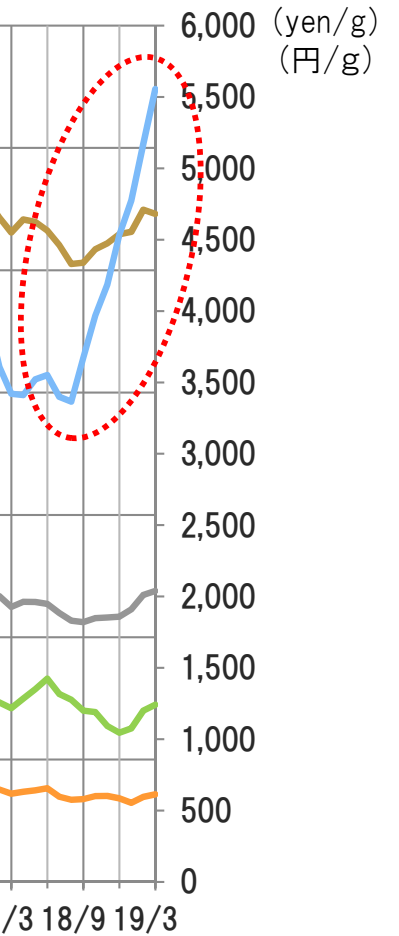
(yen/g)
(円/g)



Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格

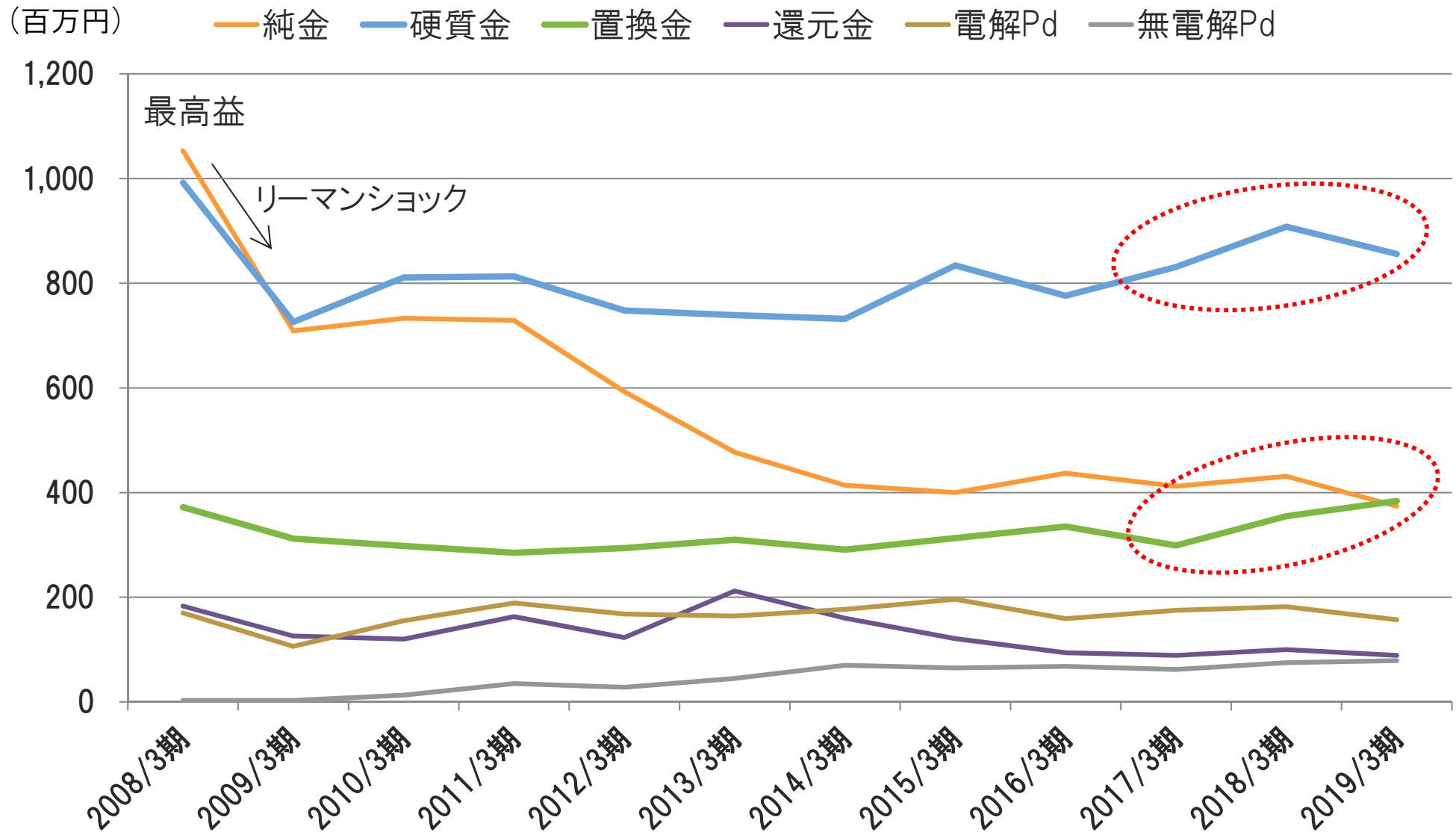
Gold 金
Palladium パラジウム

(yen/g)
(円/g)



めっき方式別利益推移

※ 概算粗利(売上総利益)



製品ラインアップ ～ラインアップ拡充と新分野開拓～

	めっき方式	用途	製品ラインアップ
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき
	硬質金 (金合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7
	電解Pd		PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき IM-GOLD IB2X 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき IM-GOLD CN
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD シアン化金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD CN
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ネオパラブライト 2 ダイレクト還元パラジウムめっき ネオパラブライト DP
新分野	新分野		後処理剤 合金めっき 卑金属(銅、スズ、ニッケル)

研究開発型企業としての新技術探索

貴金属めっきにおける固有技術

- めっきされる基材表面を制御する“Protecting Agent”（※）

※特定の金属に選択的に吸着し、電子を供与又は求引する効果によって、めっき反応や皮膜物性をコントロールする一連の有機化合物

卑金属めっきや合金めっきにおける新技術

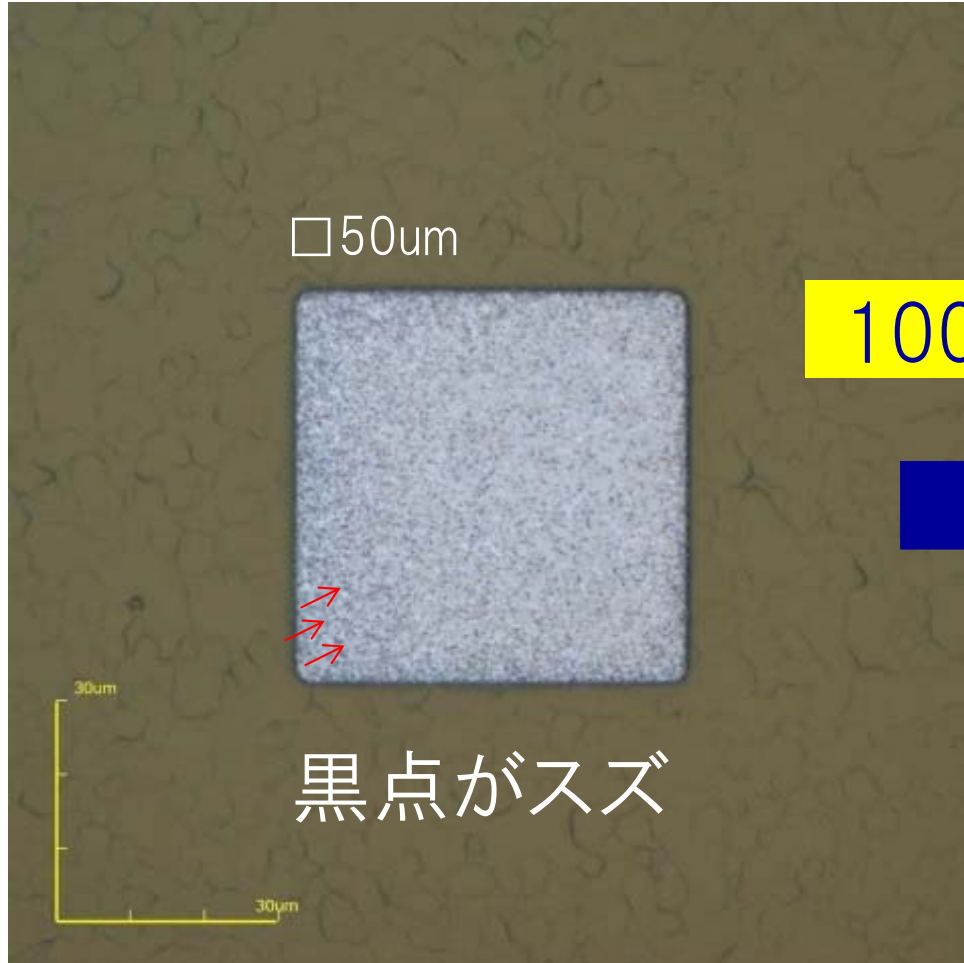
- めっき膜厚が貴金属めっきの100倍以上になり、めっき皮膜の結晶配向を制御しつつ、大幅な速度向上が必要
- ➡新技術“Charge Transfer Agent”（※）を適用する計画

※めっき液中の電荷を速やかに移動し、めっき反応を促進させる一連の有機化合物

分子構造に“Protecting Agent”や“Charge Transfer Agent”の機能を有する化合物を探索し、次世代の柱となる新製品を開発する。

還元スズめっき

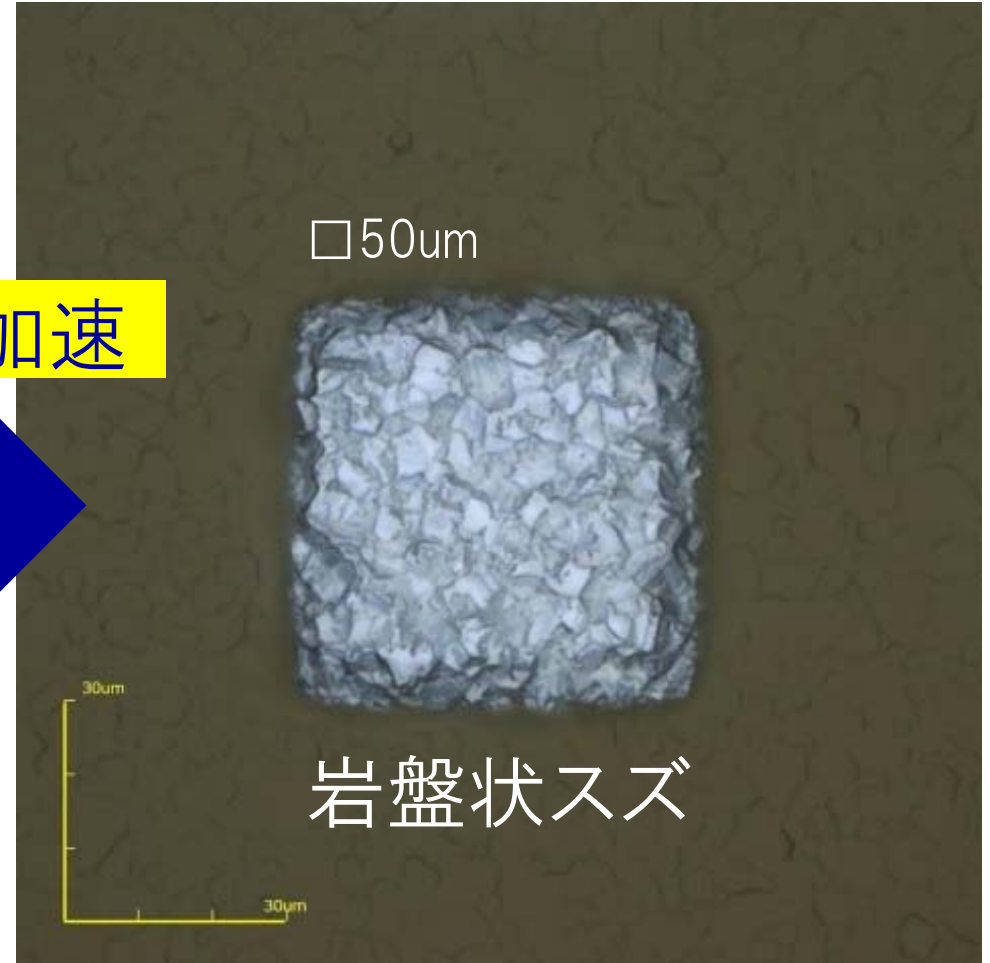
Charge Transfer Agent なし



100倍加速



Charge Transfer Agent あり



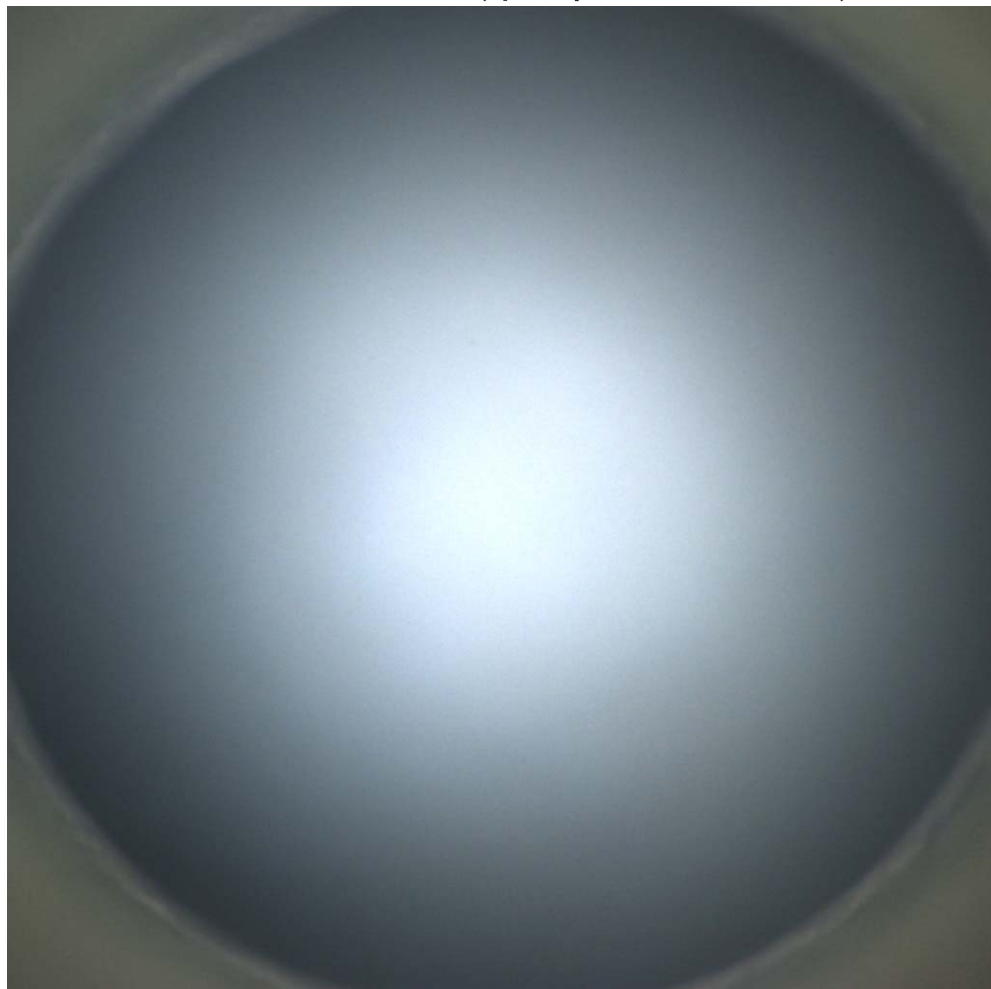
スズめっき膜厚 0.05 um未満/30分

スズめっき膜厚 5 um/30分

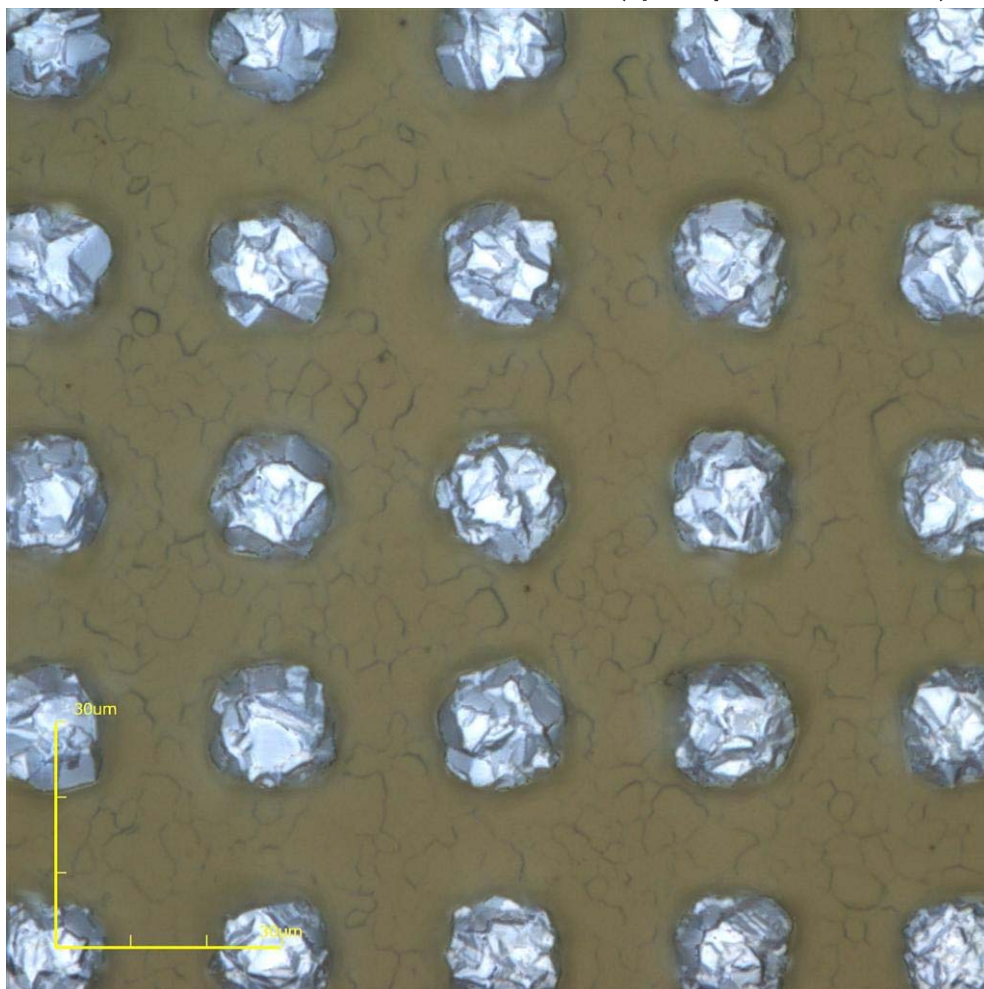
厚膜化が可能

はんだボールとマイクロめっきバンプ

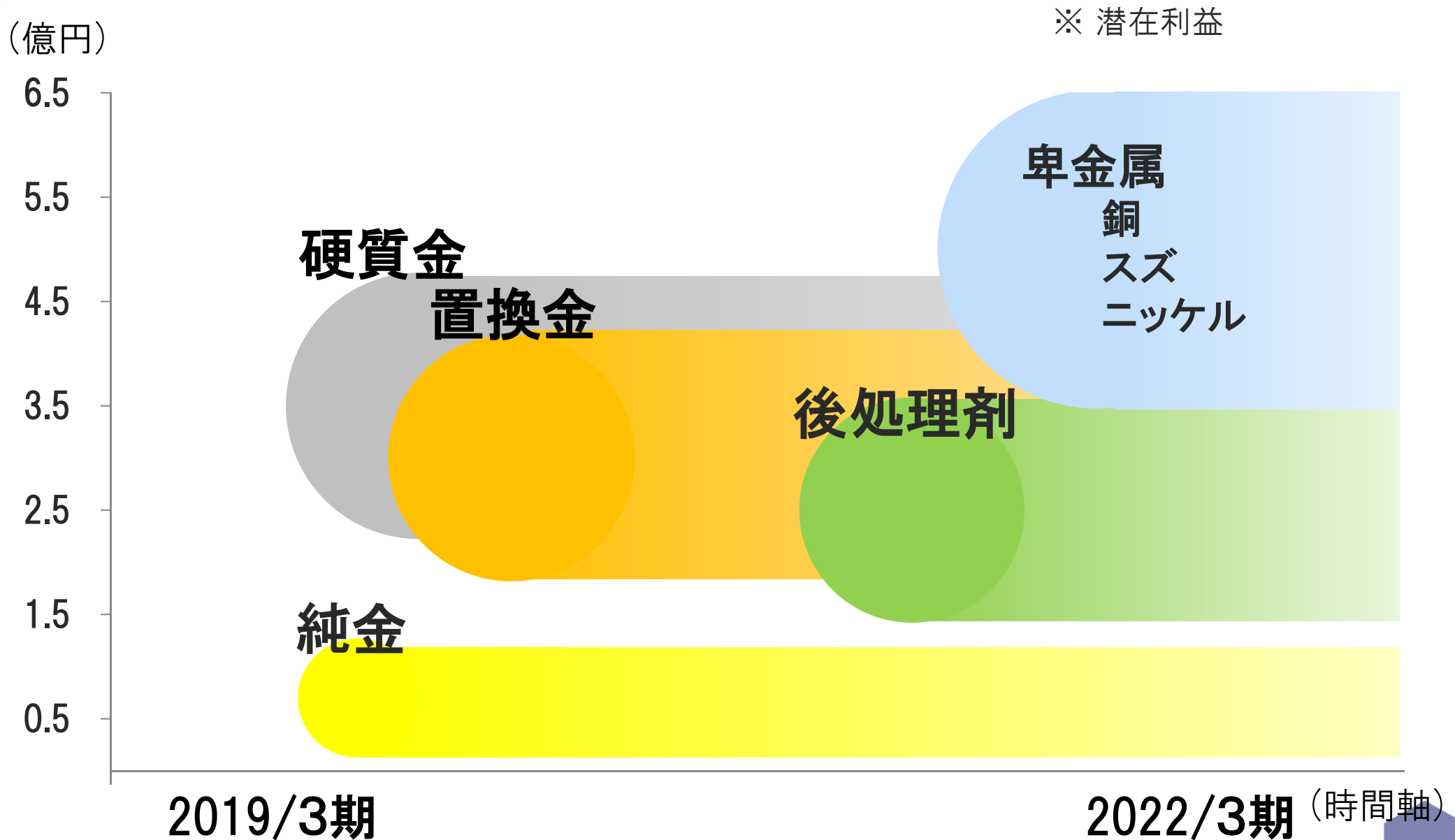
スズボール(直径150um)



マイクロめっきバンプ(直径10um)



利益貢献が見込まれる新製品群





注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2019年3月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>

補足資料： 会社紹介

沿革

- 1971年7月 会社設立
- 1999年11月 MBOを実施
- 2002年12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年3月 東京証券取引所市場第一部に指定
- 2019年2月 一般財団法人JPC奨学財団設立

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき工程に絞り世界シェアトップ
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献